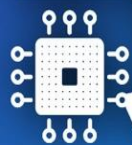


IC設計

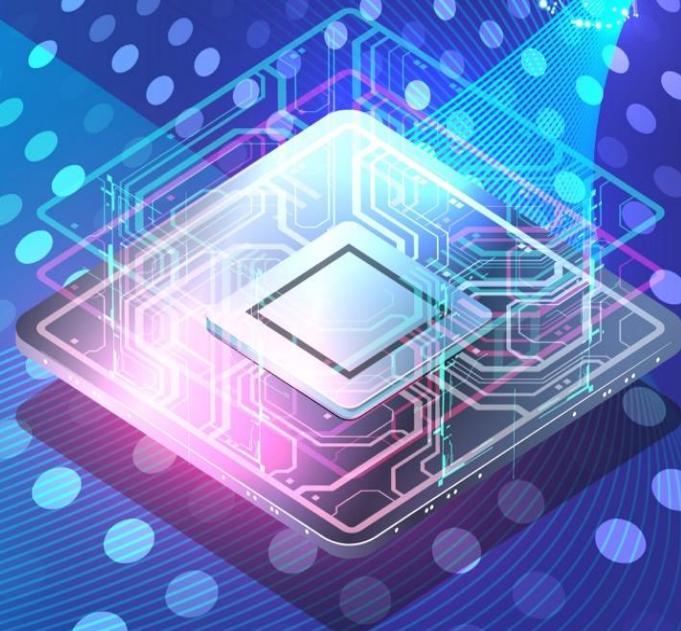


攻頂補助計畫

說明會



經濟部產業技術司
Department of Industrial Technology, MOEA




議 程

時 間	議 程	單 位
13:30-14:00	報到	
14:00-14:10	主席致詞	經濟部產業技術司長官
14:10-14:25	IC設計攻頂補助計畫 簡介說明	工研院產科國際所
14:25-14:40	IC設計攻頂補助計畫 審查流程說明	經濟部產業技術司 A+企業創新專案辦公室
14:40-15:30	Q&A	
15:30	散會	

IC設計攻頂補助計畫 說明簡報

經濟部產業技術司

115年1月



報告內容

- 一. 背景說明
- 二. 補助範疇
- 三. 申請對象、資格及注意事項
- 四. 補助科目及比例
- 五. 審查重點
- 六. 預定作業時程

一、背景說明(1/2)

- 112年3月28日台灣半導體產業協會(TSIA)發布「**台灣IC設計產業政策白皮書**」，指出IC設計產業面臨中國快速崛起、國內人才短缺問題嚴重及**投入先進技術/產品的業者屈指可數**等隱憂，亟待採取積極作為以鞏固當前的競爭優勢與市場地位。
- 經濟部產業技術司針對「國際領先突破」重點補助我國**IC設計**廠商投入**具國際領先地位**之晶片及系統研發，與加速**中小型IC設計**業者進入**先進製程領域**，以推動台灣成為IC設計領導國家。

一、背景說明(2/2)

市場引領 × 晶片創新：驅動臺灣半導體應用落地

市場態勢

- 臺灣半導體產業2024年產值為5.3兆新台幣，年成長率22.4%
- 臺灣IC設計業全球排名第二(市佔率16.8%)、晶圓代工業(市佔率68.6%)與IC封測業(市佔率49%)排名全球第一

應用導向驅動



AI應用浪潮推動資料中心、機器人與通訊技術創新，帶動晶片設計與異質整合封裝技術升級，加速產品市場化

二、補助範疇

驅動臺灣業者投入先進技術應用晶片，**等同或超越國際標竿大廠**技術指標之晶片設計開發、試產。

- ◆ 自行開發晶片：優先與**系統業者**共同提案訂定系統規格並完成應用驗證。
- ◆ 外購晶片：強調創新應用且**主要運算晶片**須為**國產晶片**。且申請補助計畫書應列出完整期末系統驗證規劃並列為查核項目。

■ 補助範疇：

一. 創新技術之晶片開發

二. **異質整合封裝**技術之創新晶片(如小晶片整合封裝模組、矽光子等其他新興應用晶片開發)

三. **異質整合微機電感測**技術之創新晶片開發，採用**0.35 μ m(含)以下**之晶圓級製程

四. 共同推動**衛星通訊、多功能機器人、無人機**等晶片與系統開發領域

五. 鼓勵運用AI技術並整合軟硬體，開發百工百業的應用系統

三、申請對象、資格及注意事項(1/2)

■ 本計畫以補助**我國晶片與系統應用業者**為主，可由單一企業或多家企業聯合申請。

■ 申請資格

國內依法登記成立之本國公司，含獨資、合夥、有限合夥事業或公司，**本國公司**之認定：

- 1) 若本國公司為外國公司依中華民國公司法在臺登記之分公司、或本國公司為外國公司之從屬公司，非屬本計畫認定之本國公司。
- 2) 若原依中華民國公司法在臺設立登記之本國公司，後因公司營運發展將部份業務轉移至國外或更改股權結構成為外國公司之從屬公司，但仍於中華民國境內進行主要營運與研發者，視為本計畫認定之本國公司。
- 3) 不得為陸資來臺投資事業；其依本部投資審議司之陸資來臺投資事業名錄認定之。

■ 本計畫採**批次收件、批次審查**，依最終評核結果及推薦順序，**擇優**對象予以補助。

■ 本計畫申請主導廠商以一案為限，且與「無人機關鍵晶片及模組自主開發研發補助計畫」及「驅動國內IC設計業者先進發展補助計畫」擇一申請。

■ 惟已參與113年及114年計畫之申請單位，及115年新申請計畫，倘申請內容屬衛星通訊、多功能機器人及無人機等晶片與系統開發領域者，不受前述之限制。

三、申請對象、資格及注意事項(2/2)

- 計畫補助期程：以不超過**2年**為原則。由本部籌組審查小組進行審查，核定通過後簽約執行，計畫執行期程可回溯至**115年4月1日**。
- 計畫申請時程：自公告日起算7日後開始受理至**115年3月31日下午5點止**；掛號郵件者以交郵當日郵戳為憑，親送或其他方式遞送者，須於115年3月31日下午5點前送達為限。
- 無形資產引進**應註明是否為政府計畫成果，若是，則該無形資產/技術引進應編列於自籌款；委託研究亦應標註是否為政府計畫成果，若是，須註明該政府計畫名稱並說明本申請計畫委託之技術項目與該政府計畫技術之區別。
- 本計畫主晶片**必需**採用**國內晶片**，且投片製造需為國內晶圓廠，如有特殊需求者，請敘明理由。

四、補助科目及比例

創新或研究發展

人事費

專利申請費

消耗性器材與
原材料費



創新或研究發展
設備使用費/維護費

無形資產引進、委
託研究或驗證費

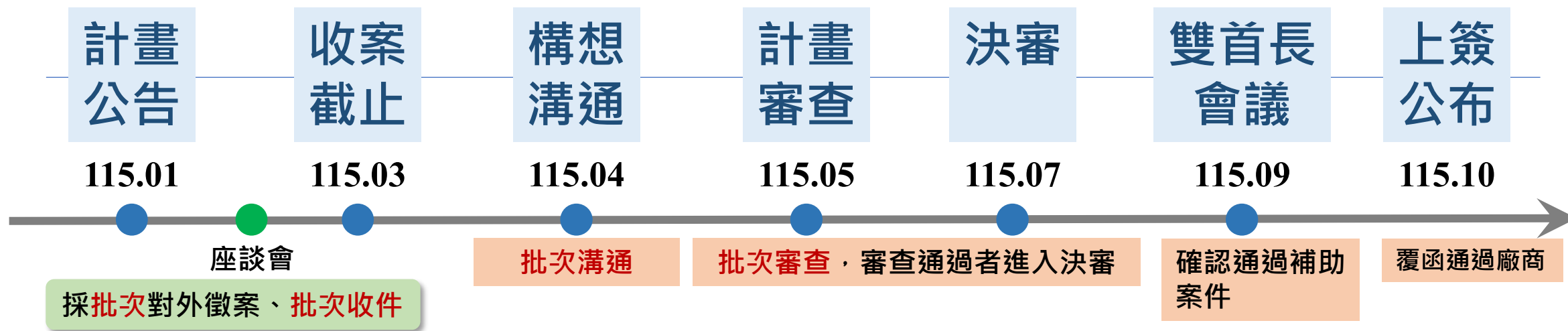
國內差旅費

- 補助比例最高不超過計畫總經費之50%，其餘部分由申請單位自籌
- 授權與委託比例超過總經費40%以上(含)，須敘明理由

五、審查重點

審查重點 (計分比例)		內涵說明
(一) 市場價值 (40%)		<p>1. 技術價值性：產業帶動效果及預估帶動規模大小。</p> <p>2. 市場競爭力：目標市場及客戶、預期產出價值及後續擴散效益具有明確性；預期結案後可提升營業指標成長率、具體的投資營運規劃。</p> <p>3. 合作共創性：有明確提出帶動國內廠商合作共創之構想及作法。</p>
(二) 技術層級 (30%)		<p>1. 技術自主性：技術項目規劃布局完整性、已有專利分析，且計畫內有明確規劃核心IP布局。</p> <p>2. 技術創新性：突破與攻堅之技術與國際技術領先廠商相比，具有領先性或等同。</p> <p>3. 技術實現性：技術研發策略明確可行，且研發成果/系統產品需提供相關測試驗證進行佐證，列入計畫查核點。</p>
(三) 計畫可行性 (30%)		<p>1. 計畫主持人及計畫團隊配置與執行經驗是否適宜，聯合提案之主導企業是否具計畫整合能力且團隊分工清楚。</p> <p>2. 計畫經費編列合理性。</p> <p>3. 查核點及驗收規劃的合理性與可行性。</p>
加分 項目	(最多5%)	考量未來市場成長性、標竿國際大廠投入與前瞻技術布局，對於衛星通訊、多功能機器人、無人機等晶片與系統開發領域提案者，將依技術難度提供加分鼓勵(最高給予5分)。
	(最多5%)	特別鼓勵提案者運用AI技術並整合軟硬體，開發百工百業的應用系統，將依技術難度給予加分鼓勵(最高給予5分)。

六、預定作業時程




(暫定時程)

敬請指教

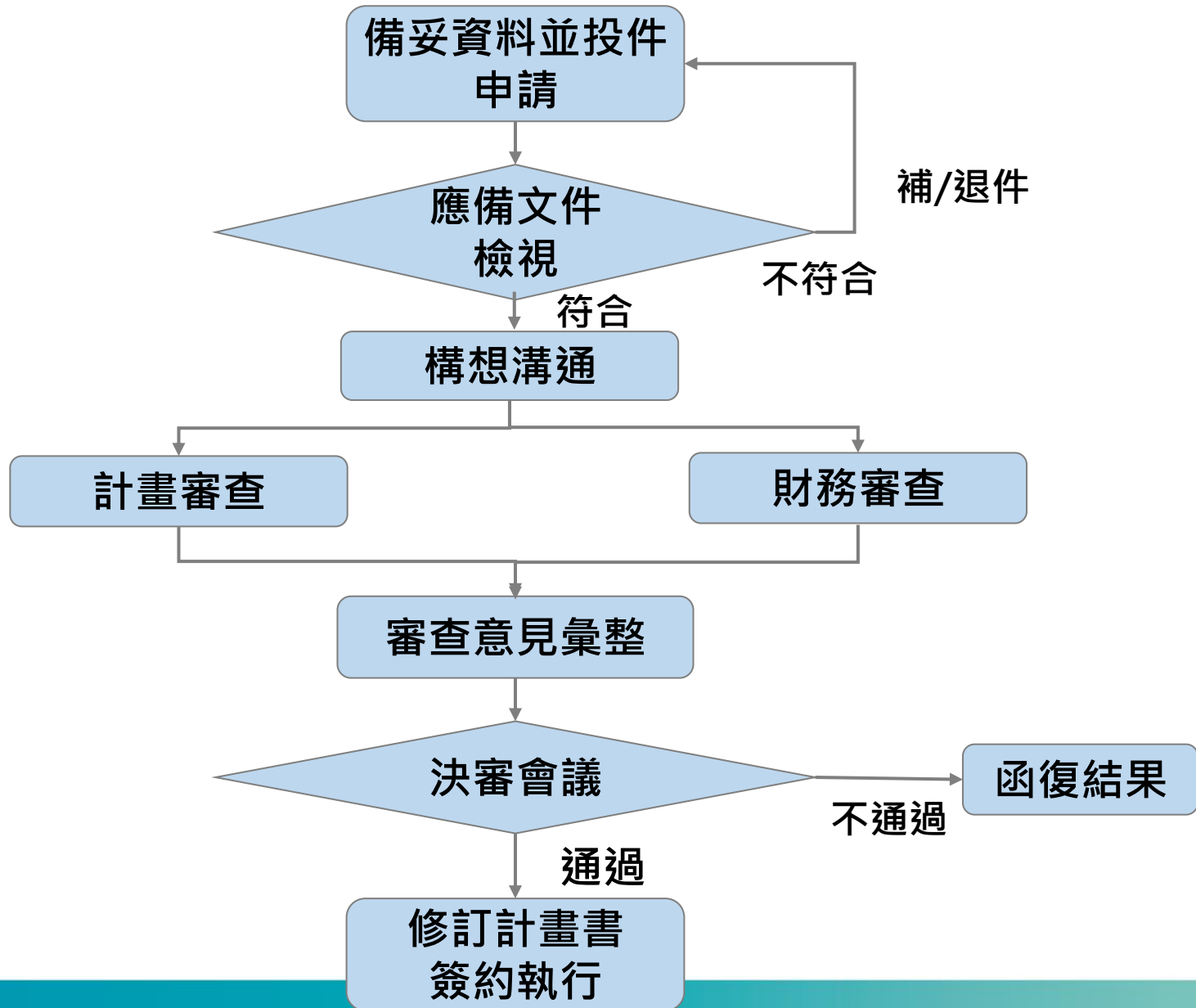
「IC設計攻頂補助計畫」 審查流程說明

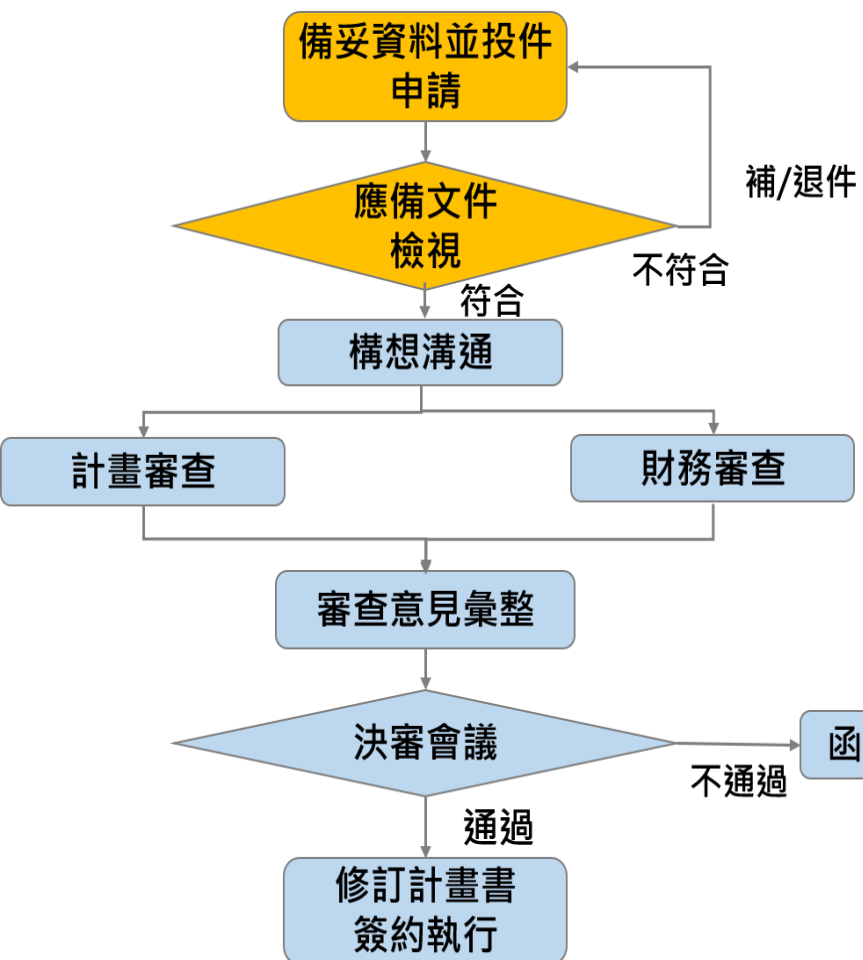
經濟部產業技術司

115年1月



審查流程





1式2份

- 計畫申請表
- 申請公司基本資料表

1式10份

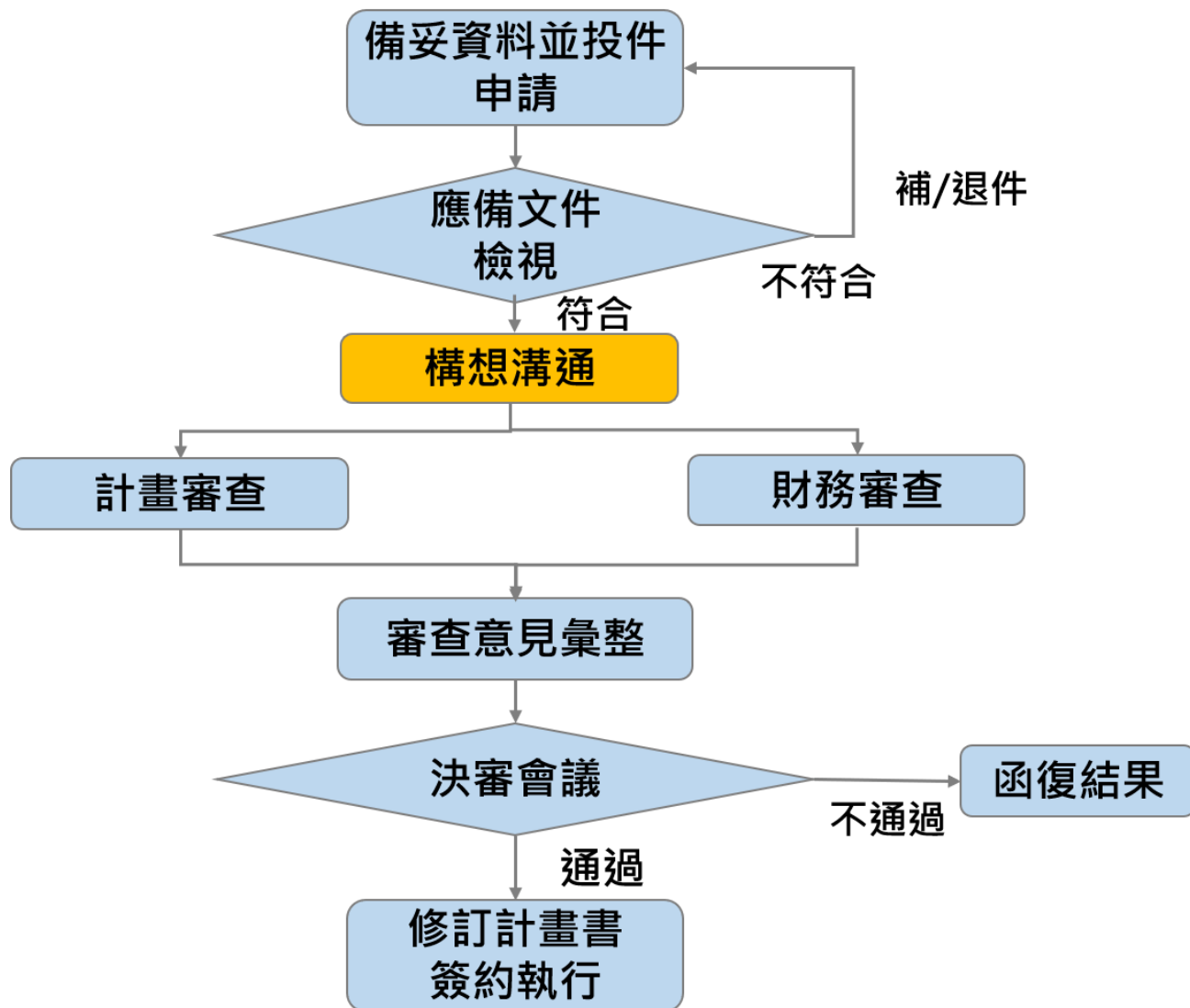
- 計畫簡報
- 計畫書

1式1份

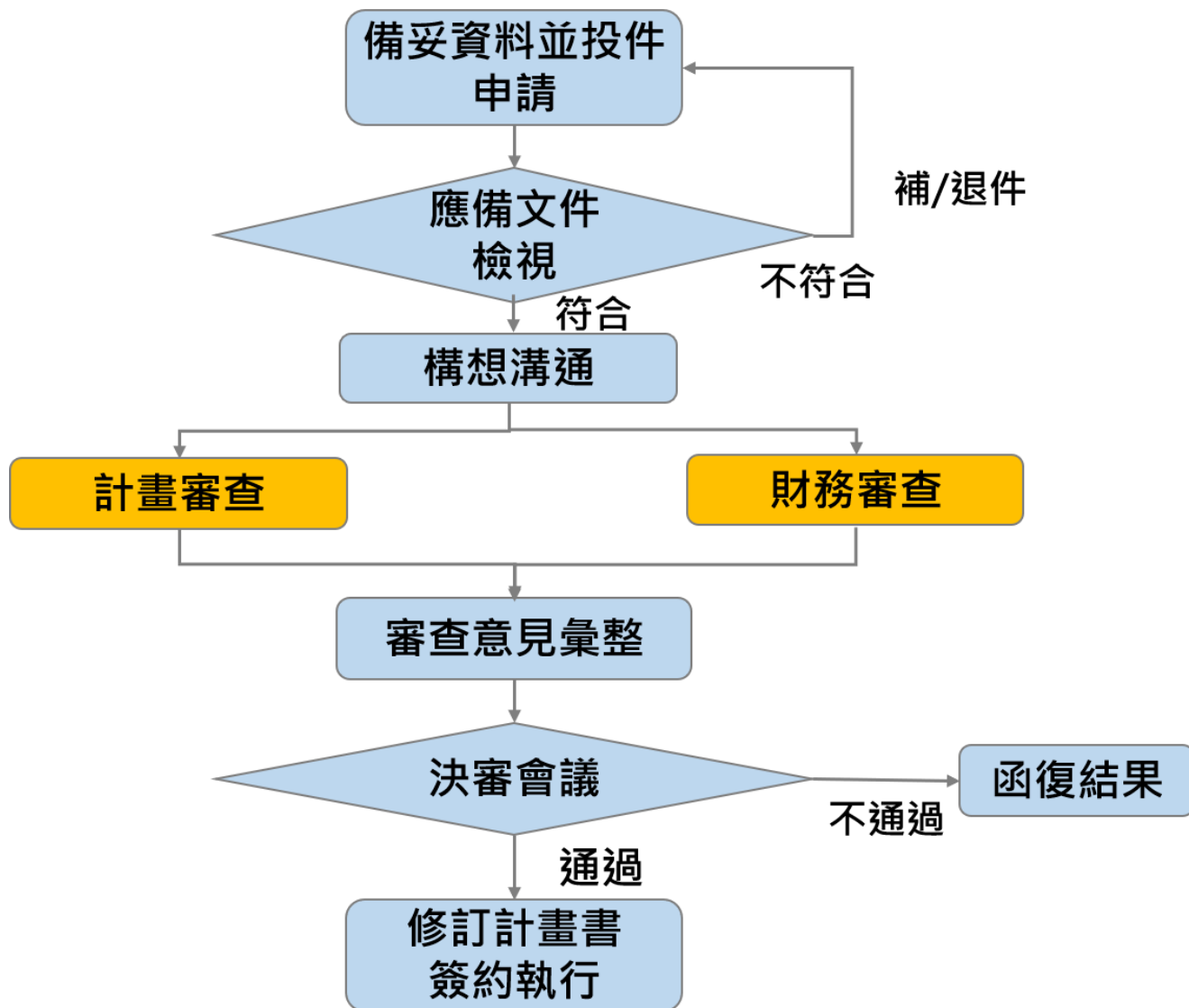
- 主導公司最近3年會計師簽證查核報告書
- 聯盟公司近1年會計師簽證查核報告書

■ 送件地址：

「經濟部產業技術司A+企業創新專案辦公室」
臺北市中正區100409重慶南路二段51號 永豐餘大樓7樓



安排構想溝通會議，由廠商進行計畫內容簡報，審查委員提供初步意見，廠商於會後可自行評估是否調整計畫簡報/計畫書。如有需要調整者，需於規定時間內提出，逾時者視同無調整。



• 計畫審查：

申請業者應出席審查會議，並由計畫主持人進行簡報。

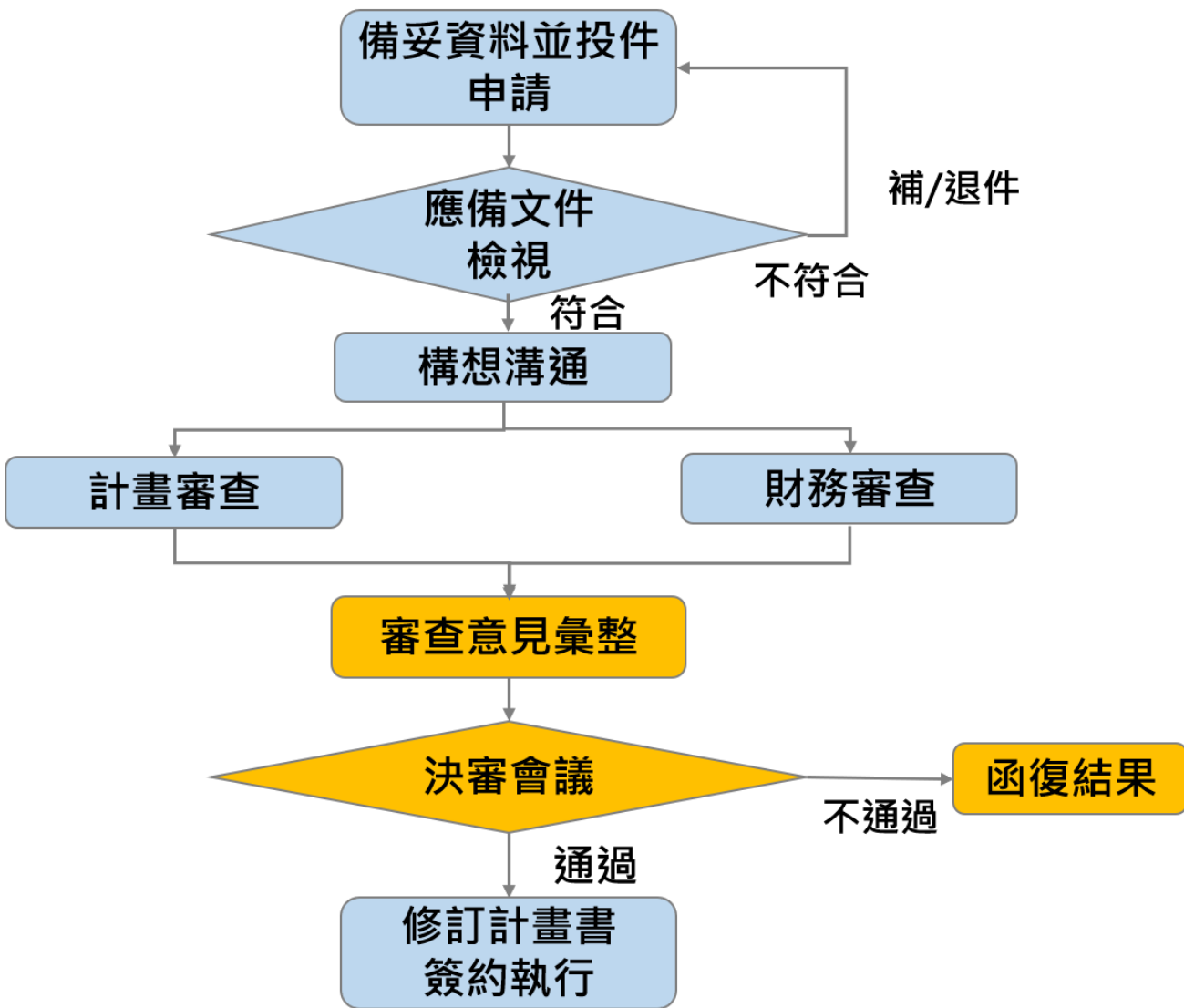
• 財務審查：

由財團法人臺灣中小企業聯合輔導基金會查詢申請單位及負責人等往來金融機構債票信資料，並評定財務審查結果。

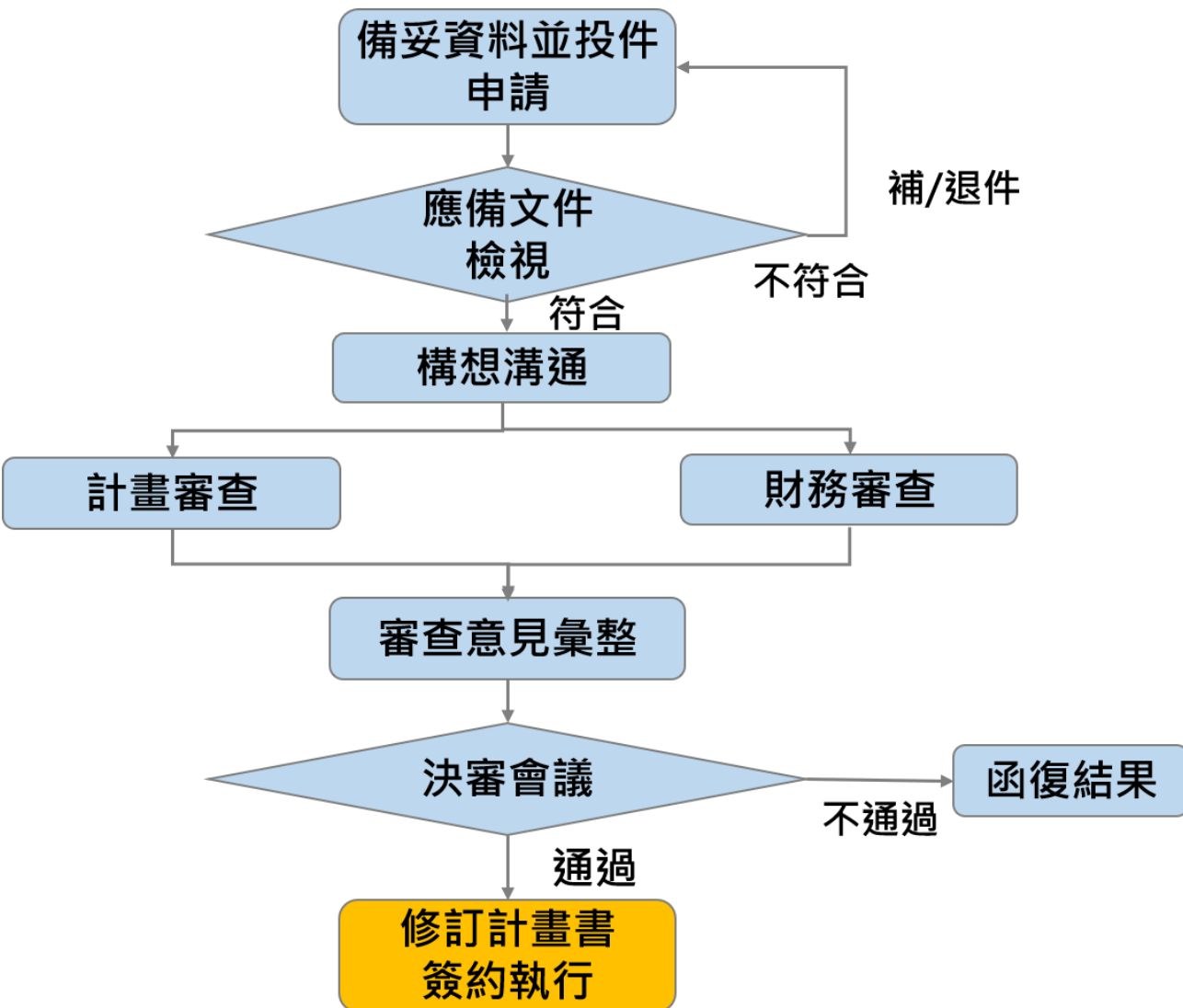
註：申請資格規定

■非屬銀行拒絕往來戶，且公司淨值(股東權益)為正值。

■不得為陸資來臺投資事業；其依本部投資審議司之陸資來臺投資事業名錄認定之。



- **決審會議：**
計畫審查獲推薦計畫，申請單位應派員列席決審會議(以計畫主持人為原則)。
決審會議將確認計畫審查及財務審查結果。**後續由本部及國科會雙首長會議核定補助款金額及比例。**



• 簽約執行：

1.應於補助核准函所定期間辦理簽約。

2.執行管考：定期交付工作報告、進行技術及財務查證作業。

3.結案作業：需繳交全程計畫結案報告。

計畫管制時程表 (以計畫時程二年為例)

時程	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6
計	1	\$					📄						📄						📄						📄					
畫	2		\$				📄						📄						📄						📄					
開	3			\$				📄						📄						📄						📄				
始	4				\$				📄						📄						📄						📄			
行	5					\$				📄						📄						📄						📄		
月	6						\$				📄						📄						📄						📄	
份	7							\$				📄						📄						📄						📄
計	7	\$					📄						📄						📄						📄					
畫	8		\$					📄						📄						📄						📄				
開	9			\$					📄						📄						📄						📄			
始	10				\$					📄						📄						📄						📄		
行	11					\$					📄						📄						📄						📄	
月	12						\$					📄						📄						📄						📄
份								\$					📄						📄						📄					📄

依全程補助經費分期撥付補助款，自計畫開始日起每6個月為一期（最後一期可為2個月~7個月）

\$申請撥款：簽約時請領計畫第1期補助款，第2期補助款之請領將依照前期工作報告內容，若計畫實際累計工作進度達預定累計工作進度之75%且經費及經費結報數累計達已撥付數之75%，可辦理請款。若未達標準，則須於其後月份更新工作報告內容達可請款條件後，再辦理請款。

📄工作報告：每期結束後次月21日前須繳交工作報告。

📖全程執行總報告：計畫結束日後30日內須繳交全程執行總報告。

※技術查證作業：原則上半年進行一次，得不定期採現場或書面查證。

※經費訪視作業：原則上每年進行一次，得不定期依通知擇期進行經費訪視。

注意事項：

➤ 補助款專戶之支領，於月結後次月方可提領當月支用數，且提領數不得高於支用數

➤ 請款須出具銀行履約保證金保證書



經濟部產業技術司
Department of Industrial Technology, MOEA



企業創新專案辦公室

相關資訊：

1

計畫網址：

<https://service.moea.gov.tw/EE514/tw/aiip/>

(申請須知等相關資料皆可由網站下載)

2

聯絡電話：02-2341-2314#2209 林先生

3

地址：100台北市重慶南路二段51號7樓



敬請指教